

Willkommen bei O-Leading

Wir sind professionelle PCB hersteller mit mehr als zehn jahren erfahrungen. Produktpalette: Einzel-, Doppelseiten-, Mehrschicht-Leiterplatten, flexible Leiterplatten und MCPCB. Wir bieten einen schnellen Prototypenservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

[\(Lieferant von Flex-Leiterplatten\)](#)

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTOPFT WERDEN

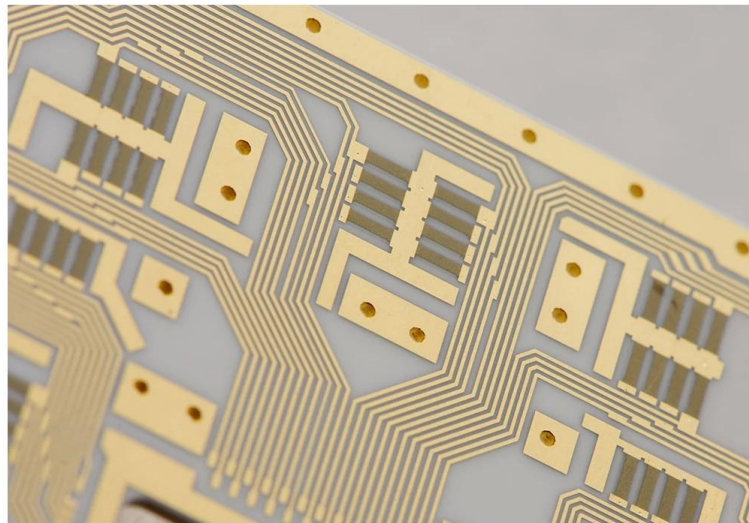
Packung mit farbloser transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, Trockenmittel in die Flanke geben, Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite legen

BITTE KLICKEN SIE HIER FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Produktbeschreibung

PCB P / N	SS-66253-A
Ebenenzahl	2L
Material	Grundkeramik
Verpflegung thk	0,80 mm
kupfer thk	1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	0,2 mm
Anzahl Löcher (Stk)	37
Linie w / s	/
Impedanzkontrolle. J / N (Tol%)	N
Oberflächenveredelung	ENIG
Lötmaske Siebdruck	N / A / Schwarz
Single Board Größe	Dim X (mm): 105; Dim Y (mm): 127
Panelisation	Abmessung X (mm): 105; Abmessung Y (mm): 127; Anzahl UPS: 1
Besonderheit: abziehbare Maske	N
Fräsen / Stanzen	CNC

•



www.o-leading.com

[Keramik PCB Hersteller China](#)

FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität? [Panel Plating Gold Großhandel](#)

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. State-of-the-Art-Prüfgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Prozess zur Fehlerfallanalyse
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Die chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Und auch unsere Arbeitskosten sind erheblich gestiegen. O-Leading hat unsere Preise jedoch stabil gehalten. Dies ist ausschließlich unseren Innovationen zur Kostensenkung, Abfallvermeidung und Effizienzsteigerung zu verdanken. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft wird für beide Seiten von Vorteil sein, wenn wir Ihnen Kosten- und Qualitätsvorteile verschaffen können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, Hoch-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers-, Arlon-, Telfon-, Aluminium- / Kupfer-Platinen, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Wie sieht der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten aus?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Innerer AOI → Mehrfachbindung → Schichtaufbau Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → Äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → Äußeres Ätzen → Äußerer AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Routing → E / T → Sichtprüfung.

Unser Team



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Zertifizierungen





No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313, FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ

Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Requested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method : Please refer to next page(s).

Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the back, available on request or accessible at <http://www.spa.com/terms-and-conditions> and, for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.spa.com/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is deemed to have accepted the terms and conditions of the document and the Company's policy of non-recourse. In accordance with the Client's instructions, if any, the Company's sole responsibility is to its Client and the document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced or used in any manner whatsoever without the prior written permission of the Company. Any unauthorized use or reproduction of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the samples tested.

www.Ch.DaschneAG.com
 SGS-Stg. No.4, Jiangnan Industrial Park, No.40, Jiang Road, Suzhou, Jiangsu District, Suzhou, China 518129 | (86-756) 25326888 | (86-756) 83106190 | www.sgsgroup.com.cn
 中国·苏州·工业园区阳澄湖半岛430号江都工业园4楼SGS之楼 邮编: 215129 | (86-756) 25326888 | (86-756) 83106190 | sas.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019

Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description:

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
SN1	SZX19-005304.001	Green™PCB

Remarks :

(1) $1 \text{ mg/kg} = 1 \text{ ppm} = 0.0001\%$

(2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Q27
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tri bromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tri bromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed elsewhere, available on request or accessible at <http://www.spa.com/terms-and-conditions.asp>, and for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.spa.com/terms-and-conditions/Terms-Electronic-Documents.asp>. It is drawn in the jurisdiction of Spain. The signature and justification required by law are hereby acknowledged. The Company has accepted and admitted that it is bound by the terms and conditions of the Contract from the time of its intervention and/or after the time of its acceptance of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced without the prior written consent of the Company. Any reproduction or distribution of this document without the prior written consent of the Company shall constitute an offence against intellectual property. The appearance of this text report refers only to the samples tested.

SGS B.V., Leiden, The Netherlands
SGS B.V., CN, Dongchuan Industrial Park, No.430, Jiuji Road, Baidian, Langgong District, Shenzhen, China 518129
中国·深圳·龙岗区田田路430号江江工业园4楼SGS大厦 邮编: 518129

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max					
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Flame	Meets	C	
	mm(in)	Edge mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class	UL796	T	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Prozessfähigkeit

PCB-Produktionsmöglichkeiten

Schicht Anzahl: 1Layer-32Layer

Fertige Kupferdicke: 1 / 3oz-12oz

Min. Linienbreite / interner Abstand: 3,0 mil / 3,0 mil

Min. Linienbreite / Abstand extern: 4.0mil / 4.0mil

Maximales Seitenverhältnis: 10: 1

Brettstärke: 0.2mm-5.0mm

Max Panel Größe (Zoll): 635 * 1500 mm

Mindestbohrlochgröße: 4mil

Plated Hole Tolerance: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All-Typen): JA

Via Fill (leitend, nicht leitend): JA

Basismaterial: FR-4, FR-4high Tg. Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid,

Schweres Kupfer

Oberflächen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Versilberung,Immersiondose, Goldfinger, Carbon-Tinte

SMT-Produktionsmöglichkeiten

Leiterplattenmaterial: FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis

Maximale Leiterplattengröße: 510 x 460 mm

Min PCB Größe: 50x50mm

PWB-Stärke: 0.5mm-4.5mm

Brettstärke: 0.5-4mm

Min. Komponentengröße: 0201

Komponente mit Standardchipgröße: 0603 und größer

Maximale Höhe der Komponente: 15 mm

Min. Steigung: 0,3 mm

Min. BGA-Kugelpitch: 0,4 mm

Platzierungsgenauigkeit: +/- 0,03 mm